

2019日本パッケージングコンテスト入賞作品記念発表会 2019パッケージングフォーラム

—入賞3作品の商品開発事例発表—

開催日時：令和元年8月29日(木)10:30~11:55

会場：東京ガーデンパレス 平安の間

主催：公益社団法人日本包装技術協会

ご参加の勧め

先頃、公益社団法人日本包装技術協会主催により年1回開催している、日本パッケージングコンテストの審査会が行われ、389件にのぼる応募作品の中から、13件のジャパンスター賞並びに43件の包装技術賞、77件の包装部門賞と合わせて133件の入賞作品が決定しました。

今回は、ジャパンスター賞に入賞された作品の中から、3作品につき商品開発事例等をご紹介します。どうぞ、この機会に関係各位お誘い併せの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。

10:30~10:55

テーマ：“お手軽輸送、楽々梱包できる”ドローン運搬箱

発表者：株式会社 デンソーロジテム 物流サービス本部 包装管理室 包装企画課 谷口 将之 氏

発表内容：デンソーでは、自動車産業に携わる企業として、安心・安全な車社会を支える道路や橋などの社会インフラ点検への貢献を目指した取り組みを開始。自動車部品開発で培ったモーターやセンサー、先進制御技術等を駆使して産業用ドローンを開発。運用に際し都市部だけでなく山間・河川・海岸等の辺境地への運搬が可能な包装材が必要となった。輸送品質の確保や屋外使用前提の耐久性は当然のこと、SDGsを考慮して、“少子高齢化社会における労働者不足”、“廃棄物による環境負荷増大”解消により、持続可能な社会の実現の一助となることを目指し、ドローン運搬箱を開発した。

11:00~11:25

テーマ：「グリナ®」「アミノエール®」スティック6本入り

発表者：味の素株式会社 食品研究所 商品開発センター 包装設計グループ 小西 遼子 氏

発表内容：味の素グループでは地球持続性に貢献する取組みの一つとして、包装設計における軽薄短小やバイオマス素材の活用などによる温室効果ガスの排出削減を進めてきた。今回はヒートシール性のない単層OPPIに対して超音波シールで製袋する技術を開発したことで、フィルム重量約3割削減を実現した。あわせて水性フレキソ印刷を採用したことにより、包材製造工程での溶剤使用量を大幅に削減した。これを当社のスティック入りサプリメントを入れる横ピロー袋として採用した。

11:30~11:55

テーマ：40年来の課題 大型重量物木枠包装からALL段ボール包装化実現

発表者：中津川包装工業株式会社 営業本部 販売推進部 部長 大山 孝一 氏
中津川包装工業株式会社 営業本部 販売推進部 竹内 美帆 氏

発表内容：ダイキン工業様では、輸出開始40年以上木枠包装にて空調機器全般の室内機・室外機の補修用部品を世界各国に統一仕様で出荷されてきました。現行仕様は1980×1130×1120 最大積載重量800kg。幾度かALL段ボール化にチャレンジされていたが実現していませんでした。地球環境問題への取り組みCO2削減として脱木材へ完全移行する。働き方改革として作業環境改善を図り“誰でもできる梱包仕様”を目指し、トータル物流費削減を目的とした。現状抱える課題は、木枠組立に於いて専属職人の高齢化・釘打ちによる騒音問題、近年輸出増加に伴う梱包時間の増加また、作業者の人手不足が深刻な問題であった。今回ALL段ボール包装化実現により様々な問題を解決し、長年の課題である脱木材達成することが出来ました。包装のし易さ、開梱のし易さ、誰でもできる梱包仕様が完成。トータル物流費20%削減。環境に配慮・人に優しくできた作品をご紹介します。

開催要領

名称：2019パッケージングフォーラム
日時：令和元年8月29日(木) 10:30～11:55
会場：東京ガーデンパレス 平安の間
東京都文京区湯島1-7-5
定員：150名
参加料：無料
同時開催：2019パッケージングコンテスト表彰式
(同会場高千穂の間 14:00～)

交通経路

●最寄駅

- ・JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」聖橋口(東京駅寄りの改札)より徒歩5分
- ・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩5分
- ・東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩5分
- ・東京メトロ銀座線「末広町駅」より徒歩8分

●新宿駅より

- ・JR中央線快速10分

●東京駅より

- ・タクシーにて約15分
- ・JR中央線5分「御茶ノ水駅」下車

●羽田空港より

- ・タクシーにて約50分
- ・東京モノレール空港快速で約19分「浜松町駅」にてJR線のりかえ、東京駅または神田駅にて中央線に乗りかえ「御茶ノ水駅」下車(空港からの所要時間約50分)

会場案内図



申込方法

2019パッケージングフォーラムの参加申し込み方法について

2019年度より、当会研究会のお申し込みを、ホームページからのみの受付とさせていただきます。お手数でございますが、当会ホームページをご覧の上、研究会お申し込みページより、参加登録を頂きたくお願い申し上げます。

URL:<http://www.jpi.or.jp/index.html>

- ・参加の受付出来ない場合のみご連絡します。当方より連絡がない場合直接会場にご来場下さい。

【個人情報の取り扱いについて】

1. 個人情報は「2019パッケージングフォーラム」の事業実施に関わる資料等の作成、並びに当会が主催・実施する事業におけるサービスの提供や事業のご案内等のために利用させていただきます。なお、作成資料は、開催当日関係者に限り配布する場合があります。
2. 参加申し込みによりご提供いただいた個人情報は、法令に基づく場合などを除き第三者に開示・提供することはありません。

お問い合わせ

公益社団法人日本包装技術協会 パッケージングフォーラム係 担当:佐藤
〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル10F
TEL.03-3543-1189/FAX.03-3543-8970/e-mail:satou@jpi.or.jp